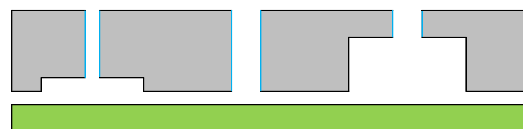
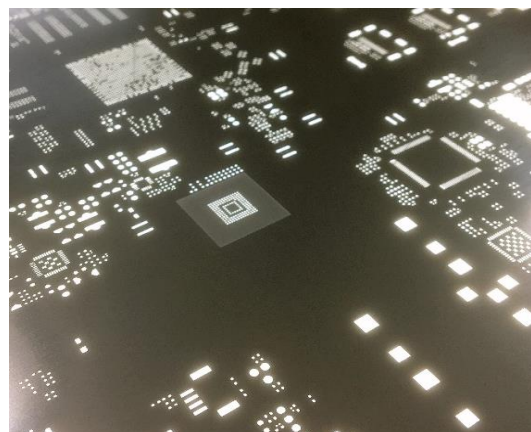
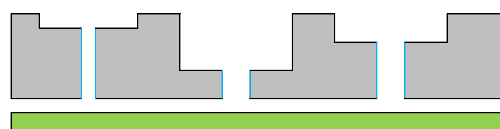
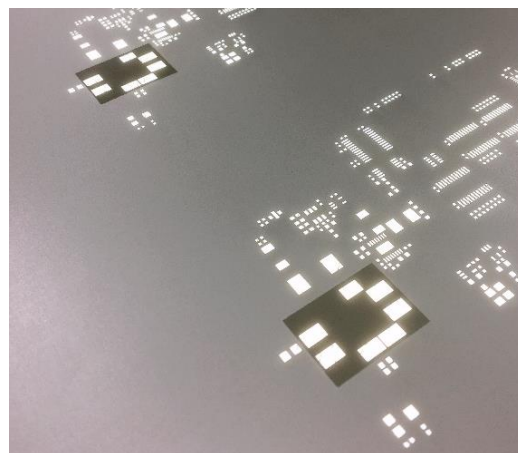


混載部品搭載に最適、
部分的に板厚を増減することにより、はんだ量の調整が可能



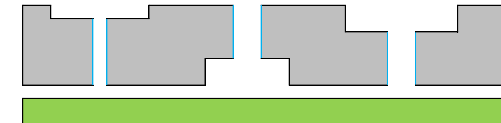
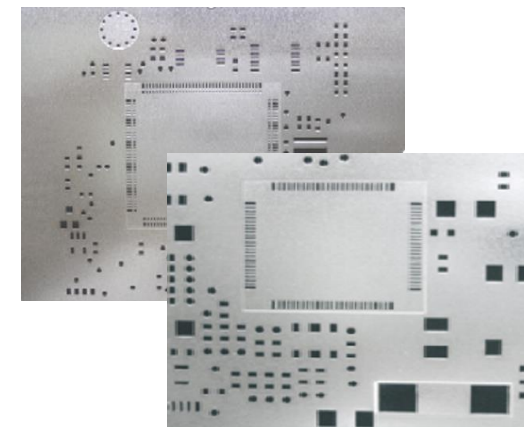
基板面側ハーフ

スキージを気にせず印刷



スキージ面側ハーフ

基板の滲みを気にせず印刷



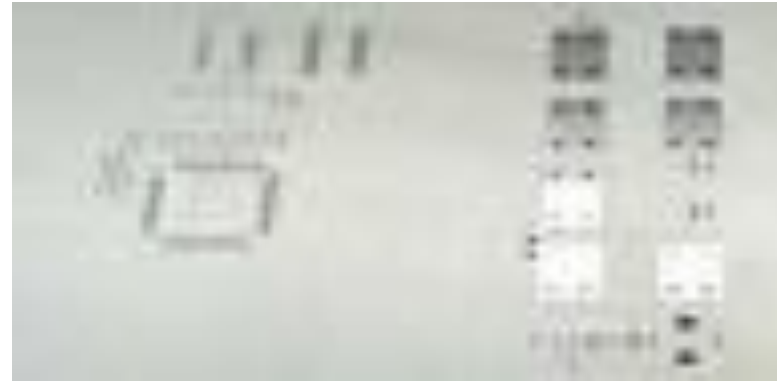
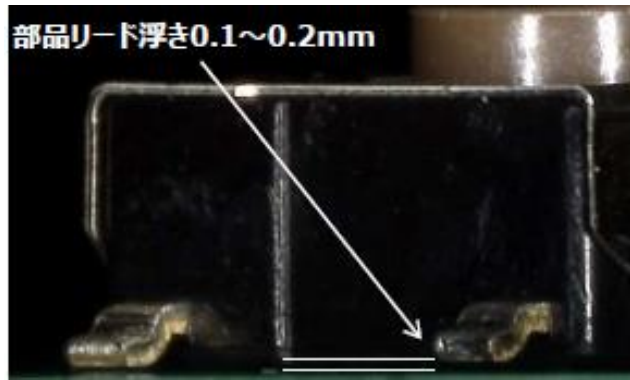
両面ハーフ

大型部品ははんだを多く
小型部品ははんだを少なく
バランス良く印刷

スイッチのリード高さにバラツキが…高確率で未はんだがでてしまう

⇒ アイランドハーフメタルマスクをご提案

※スイッチ部メタル厚 + $30\mu\text{m}$ (基板接触面側)



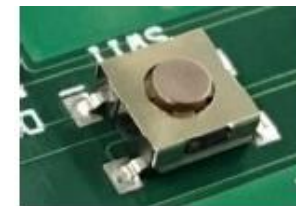
◆結果

ご提案前

7シート中7シート全てで未はんだ発生

アイランドハーフ処理
ご提案後

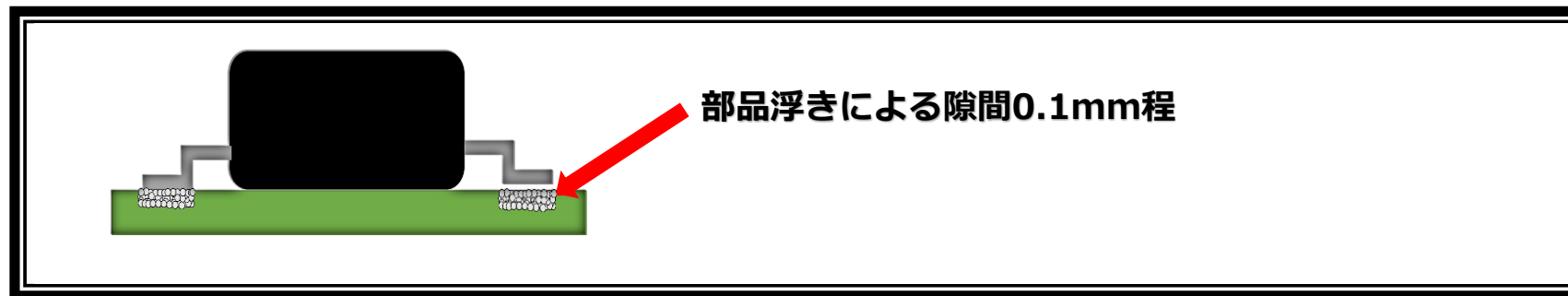
7シート全てで不良率がゼロに。他部品への影響もなし。



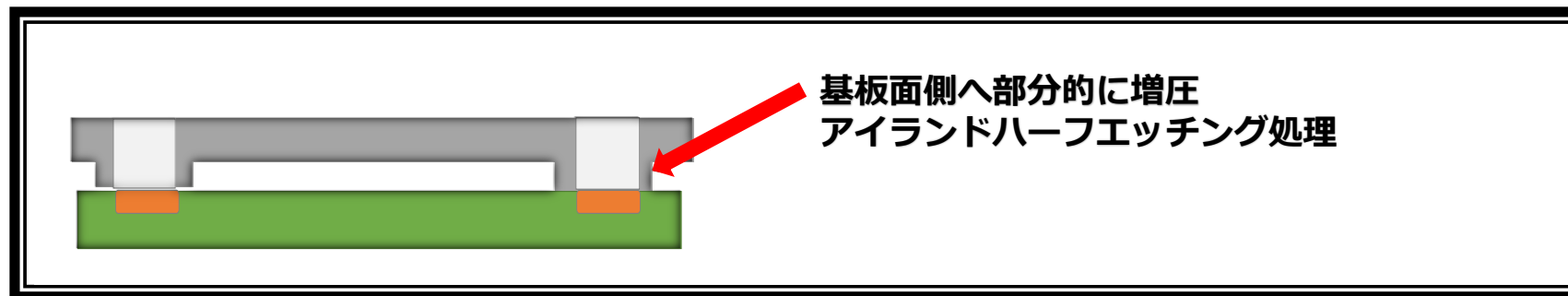
リードからの
フィレット形成が確認できた。

事例：部品のリード浮き不良

問題



処理



改善

